



08.10.2014 – 14:13 Uhr

Neuer NFC-Chip von Samsung Electronics mit Embedded-Flash bietet höhere HF-Leistungsfähigkeit in einem kleinen Gehäuse

Korea (ots) -

Samsung Electronics Co. Ltd., ein führender Anbieter von innovativen Halbleiterlösungen, stellt seinen neuen NFC-Chip (Near Field Communication) S3FWRN5 vor. Der S3FWRN5 zeichnet sich durch seine hohe HF-Leistungsfähigkeit und kleinen Gehäuseabmessungen aus. Gegenüber seinem Vorgänger S3FNRN3 verdoppelt sich die HF-Leistungsfähigkeit des neuen Chips in den Lese- sowie auch in Karten Emulations-Betriebsarten.

"Mit jeder neuen Mobilgerätegengeneration, einschließlich Smartphones, müssen die Entwickler Produkte realisieren, die Benutzern mehr Komfort bieten und sie noch intensiver vernetzen," sagt Dr. Kyushik Hong, Vice President of Marketing, System LSI Business, Samsung Electronics. "Zur Unterstützung der Entwickler, die diese Ziele erreichen und Mobilgeräte der nächsten Generation entwickeln möchten, werden wir auch künftig innovative NFC-Technologielösungen anbieten."

Mit Gehäuseabmessungen von 2,4mm x 2,4mm, die branchenweit kleinsten für Standalone NFC-ICs, ermöglicht der neue NFC-IC Mobilgeräteentwicklern ein flexibleres und effizienteres Leiterplattenlayout. Smartphone-Hersteller können den Chip wegen seiner Anschlusskompatibilität auf einfache Weise auch als Standalone NFC-IC oder NFC System-in-Package (SiP) mit "embedded Secure Element" (eSE) einsetzen.

Als industrieweit einziger NFC-IC, der in einem 45nm e-Flash-Prozess gefertigt wird, erlaubt der S3FWRN5 einfache und sichere Firmware-Aktualisierungen ohne Re-Design der Architektur. Der e-Flash-Bereich lässt sich über Firmware Updates sicher modifizieren, wenn die Funktionen des Chips um neue Leistungsmerkmale erweitert werden müssen. Dies ermöglicht Mobilgeräteherstellern eine kürzere Entwicklungszeit als mit Lösungen auf ROM-Basis (Read Only Memory).

Der S3FWRN5 beinhaltet auch die LPS-Technologie (Low Power Sensing) von Samsung - ein neu optimierter Algorithmus zum Aufspüren von Signalen bei geringst möglicher Leistungsaufnahme. Die Technologie minimiert den Energieverbrauch des NFC-ICs, wenn er kontinuierliche Signale sendet, um andere NFC-Geräte oder NFC-Tags zu erkennen. Durch den Einsatz der LPS-Technologie wird die Leistungsaufnahme des Chips, verglichen mit Samsungs früherem NFC-Produkt, um etwa 25% reduziert.

Aufgrund ihrer beeindruckenden HF-Leistungsfähigkeit hat die neue NFC-Lösung weltweit mehrere NFC-Zertifizierungen erhalten. Diese wurden von namhaften Organisationen wie Europay, MasterCard und Visa (EMV), China UnionPay, China Mobile Communication Corporation (CMCC) und NFC Forum weltweit auch für die universelle Kompatibilität der Lösung zu kontaktlosen NFC-Lesern und NFC-Tags vergeben.

Samsung hat mit der Massenproduktion des 45nm e-Flash NFC-ICs in der zweiten Jahreshälfte 2014 begonnen. Der NFC-IC ist im neuesten Flaggschiff-Smartphone Galaxy Note 4 von Samsung enthalten. Samsung wird den Einsatz dieser NFC-Lösung auf dem globalen Markt weiter vorantreiben.

Über Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie, die Menschen überall neue Möglichkeiten eröffnet. Durch kontinuierliche Innovation und Marktbeobachtung transformiert das Unternehmen die Welten der Fernsehgeräte, Smartphones, Tablets, PCs, Kameras, Haushaltsgeräte, Drucker, LTE-Systeme, Medizingeräte, Halbleiter und LED-Lösungen. Bei Samsung Electronics Co. Ltd. sind 286000 Menschen in 80 Ländern beschäftigt. Der jährliche Umsatz des Unternehmens beträgt über US\$216,7 Mrd. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com.

Über Samsung Semiconductor Europe

Samsung Semiconductor Europe, eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. Seoul, Korea, mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt/Main unterhält Büros in ganz Europa und in der Region EMEA (Middle East & Africa). Der europäische Hauptsitz ist für die Marketing- und Verkaufsaktivitäten der Component Business Units von Samsung Electronics zuständig. Dazu gehören die Bereiche Memory, System LSI, LED und Display Business in EMEA. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com/semiconductor.

Samsung und das stilisierte Samsung Design sind Warenzeichen und Servicebezeichnungen von Samsung Electronics Co. Ltd. andere Warenzeichen befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Kontakt:

Ujeong Jahnke
Samsung Semiconductor Europe GmbH
Tel. +49(0)6196-66-3300, Fax +49(0)6196-66-23525
Email: ujeong.j@samsung.com

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100017914/100762618> abgerufen werden.